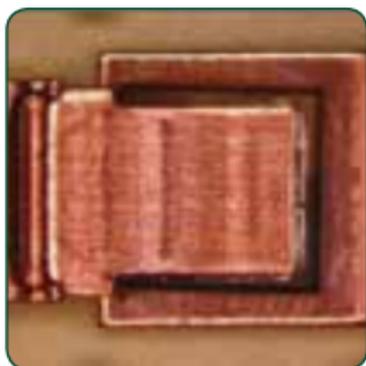
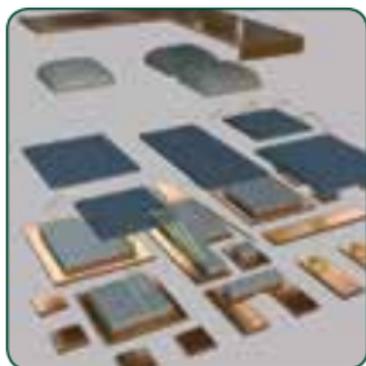


NC-SMQ[®]75 功率半导体 芯片粘接焊锡膏

Best in
class!



- 回流后残留极低 <0.5% 焊锡膏比重
- “Power-Safe” 残留，与塑封材料兼容，无分层
- 一致的点胶沉积尺寸，无堵塞
- 与多种合金兼容
- 在温度不超过400°C低氧或者混合气体 (<100ppmO₂) 中回流
- 低空洞
- 在常见金属表面上润湿良好



china@indium.com

ISO 9001
REGISTERED

表格编号: 99640 R0
©2019 钢泰公司


INDIUM
CORPORATION[®]

标准芯片粘接焊锡膏 使用合金

常用合金		成分 % w/w						°C	
无铅	注释	Sn	Ag	Sb	Pb	Au	In	固相线	液相线
		用于低Tj IGBT	96.5	3.5					221
	高可靠性	65	25	10				233	340
	最常用的锡合金	90		10				243	257
	高剪切强度、高成本	20				80		280	共晶
含铅	控制倾斜		2.5		92.5		5	300	310
	汽车电子	5			95			308	312
		10			90			275	302
		5	2.5		92.5			287	296
		2	2.5		95.5			299	304

主要使用对象

- 所有的主要功率半导体 IDMs 和 OSATs
- 移动设备、消费电子用品和汽车电子等



china@indium.com

ISO 9001
REGISTERED

表格编号: 99640 R0
©2019 钢泰公司

